

## ST-에릭슨, 중국 기업 호지(Hojoy)와의 제휴 강화를 통해 중국 컴퓨팅 시장에 고속 모바일 브로드밴드 제공

2009년 10월 13일 – 무선 플랫폼과 반도체 분야를 선도하는 세계적인 기업인 ST-에릭슨은 EDGE 및 TD-SCDMA 데이터 솔루션 전문 기업인 호지 와이어리스 (Hojoy Wireless)와 협력을 강화하고 중국 컴퓨팅 시장에 고속 모바일 서비스를 선보이게 된다고 오늘 발표했다. 호지는 중국 시장을 겨냥하여 데이터 카드, USB 동글(dongles), 노트북, 스마트폰을 위한 차세대 고속 모바일 브로드밴드 모듈을 개발하기 위해 ST 에릭슨의 중국 지사인 T3G 가 개발한 업계 최초의 65-nm TD-HSPA 모뎀인 M6718 을 채택했다.

ST-에릭슨의 파스칼 랑글루아 (Pascal Langlois) 영업 마케팅 부문 책임자는 “호지는 무선 데이터 카드와 모듈 제품을 공급하는 대표적인 선두 기업”이라면서 “회사의 차세대 TD-SCDMA 솔루션을 통해 중국 소비자들이 진정한 의미의 모바일 인터넷 경험을 보장하는 고속 모바일 브로드밴드를 즐길 수 있게 될 것”이라고 밝혔다.

호지의 챔피언 왕 (Champion Wang) 대표는 “ST-에릭슨은 중국 TD-SCDMA 시장의 혁신을 이끌고 있다”면서 “ST 에릭슨의 활발한 R&D, 중국 시장에 특화된 솔루션에 대한 전문성, 다양한 글로벌 플랫폼 솔루션에 힘입어 회사 고객들의 요구에 부합하고 빠르게 변화하는 시장에 대처할 수 있게 될 것”이라고 기대감을 표시했다.

ST-에릭슨은 호지와 오랜 동안 협력 관계를 유지해 오고 있으며, 올해 초 선보인 델 인스피론 미니 10 노트북과 알카텔 상하이 벨의 T920 USB 데이터 카드를 비롯하여 다양한 기능을 갖춘

최종 제품을 제공하고 있다.

M6718 에 기초한 호지의 모듈은 2010년 1 분기에 출시될 예정이다.

#### 편집자 주

M6718 에 대한 자세한 내용은 <http://www.stericsson.com/platforms/M6718.jsp>에서 확인할 수 있다.

#### ST-에릭슨(ST-Ericsson) 관련정보

ST-에릭슨은 다양한 모바일 기술에 대한 혁신적인 모바일 플랫폼과 최첨단 무선 반도체 솔루션 포트폴리오를 개발 및 제공하는 세계 선두 기업이다. ST-에릭슨은 최고 단말기 제조업체의 주요 공급업체이며, ST-에릭슨의 제품 및 기술은 오늘날 사용되고 있는 50% 이상의 휴대폰에 적용되고 있다. ST-에릭슨은 2008년 약 36억 달러의 예상 수익을 창출하였다. ST-에릭슨은 ST 마이크로일렉트로닉스(NYSE: STM)와 에릭슨(NASDAQ: ERIC)의 50 대 50의 합작투자자로 2009년 2월 설립되었으며, 스위스 제네바에 본사를 두고 있다. 보다 상세한 정보는 [www.stericsson.com](http://www.stericsson.com)에서 확인할 수 있다.

#### 문의처

##### Media Relations

Phone: +41 22 930 2733

Email: [media.relations@stericsson.com](mailto:media.relations@stericsson.com)



보고자료

2009년 10월 13일

**Investor Relations**

Phone: +41 22 929 6973

Email: [investor.relations@stericsson.com](mailto:investor.relations@stericsson.com)